



2020年10月19日

各 位

会 社 名 株式会社宮入バルブ製作所
代表者名 代表取締役社長 西田 憲司
(コード番号 6495 東証第2部)
問合せ先 取締役経営管理部長 市川 浩
(TEL 03-3535-5575)

業務提携に関わる基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、インターバルブテクノロジー株式会社（以下、「インターバルブテクノロジー」）およびBeijing Gritek & IVT Technology Co., Ltd.（以下、「BGIT社」）との間で業務提携に関わる基本合意書を締結することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 業務提携の目的および理由

当社は、主に日本国内市場に向け、LPガスを中心とした高圧ガス容器用弁、貯蔵・運搬設備用弁、その他関連機器類の製造・販売を中核事業としてきましたが、最近ではLNG用弁や液体水素用弁等の低温弁事業を拡大させつつ、食品加工用サニタリー弁、ミストノズル、ワインろ過機等の新事業分野における製品開発を進め、部品加工請負事業を立ち上げるなど、事業分野を積極的に拡大および多様化しております。

インターバルブテクノロジーは、チタン、ジルコニウム等特殊材料による化学プラント向けバルブの製造・販売を中核事業としており、近年では中国・アジア市場を中心とした海外取引が増加しております。また、本年1月には、中国の半導体ウエハメーカーである有研半導体材料有限公司（※）と合弁によりBGIT社（有研半導体材料有限公司51%、インターバルブテクノロジー49%）を設立し、中国国内に向けて半導体製造装置用バルブのOEM調達・販売事業を開始しております。

当社では、インターバルブテクノロジーおよびBGIT社との業務提携について慎重に検討のところ、3社の事業領域が地域的および製品分野的に重複せず、むしろ補完関係にあるので、それぞれの得意分野で経営資源を共有し協働することで、各社の事業が大きく拡大する可能性があるとの結論に達しました。また、インターバルブテクノロジーおよびBGIT社ともに同様の認識を共有していることが確認できましたので、本基本合意書を締結する運びとなりました。

（※）有研半導体材料有限公司（以下「GRITEK社」）は、株式会社RS Technologies（東証第一部）の連結子会社であり、同社は2020年9月11日付「当社海外子会社の上場準備に関するお知らせ」により、GRITEK社を上海証券取引所の新興企業向け市場である科创板市場（スター・マーケット）に上場するための準備を行うことを開示しております。

2. 基本合意書の内容

各社のスタッフによる共同のワーキンググループを組成し、以下の業務提携項目について具体的な方法およびその内容を協議することを合意するものです。

- ① 当社の製品をインターバルブテクノロジーとBGIT社が連携して中国で販売すること。
- ② インターバルブテクノロジーが製造する製品の部品を当社が製造すること。
- ③ 当社が製造に使用する部品、材料をインターバルブテクノロジーとBGIT社が連携して主として中国から調達すること。
- ④ BGIT社が販売する製品を当社とインターバルブテクノロジーが協力して製造すること。
- ⑤ その他、上記各項目を達成するため、または、本基本合意書の目的達成に必要な一切の事項。

3. 相手先の概要

① インターバルブテクノロジー

(1) 名称	インターバルブテクノロジー株式会社
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目33-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小峰衛
(4) 事業内容	化学プラント向けバルブ等製造・販売
(5) 資本金	100 百万円
(6) 設立年月	1928 年 1 月
(7) 当社との関係	資本関係、取引関係、人的関係、関連当事者への該当状況は特にありません。

② BGIT 社

(1) 名称	Beijing Gritek & IVT Technology Co., Ltd.
(2) 所在地	中華人民共和国北京市順義区林河開発区双河大街 10 号 4 幢 2 層
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 張果虎
(4) 事業内容	半導体製造装置用バルブ等の販売
(5) 資本金	1,000 千米ドル (GRITEK 社 51%、インターバルブテクノロジー49%)
(6) 設立年月	2020 年 3 月 12 日
(7) 当社との関係	資本関係、取引関係、人的関係、関連当事者への該当状況は特にありません。

4. 今後の見通し

本件による 2021 年 3 月期当社業績に与える影響は軽微であります。今後、重要な影響が見込まれる場合には速やかに公表いたします。

以上